

FUJITSU Component 無線モジュール

Bluetooth® Smart モジュール

MBH7BLZ01-109003、MBH7BLZ02-109004

Bluetooth Smart 技術を搭載し、低消費電力で超小形の、当社ファームウェア非搭載ペリフェラルモジュール*です。

*お客様で上位プロファイルとアプリケーションを開発してご使用いただくタイプのモジュールです。



RoHS適合

お客様独自処理をモジュール内に組み込み可能

Nordic Semiconductor ASAのSoC “nRF51822” を搭載し、同社のツールを使用して上位プロファイル（プライベートプロファイルを含む）とアプリケーションを自由に開発できます。外部MCUを使用せず、本モジュールだけで全機能を実現する構成も可能です。お客様の開発自由度向上のため、SoCのGPIO端子はすべてモジュールに割り当てられています。

充実したサポート

お客様が開発したソフトウェアの書き込みサービスやお客様機器上のアンテナ特性最適化のサポートをいたします。（有償サービスになります）

アプリケーション

各種情報ロガー、各種センサーデータ通信、各種ウェアラブル機器など



(写真下からMBH7BLZ01-109003、MBH7BLZ02-109004)

■一般仕様

項目	仕様	
形格	MBH7BLZ01-109003	MBH7BLZ02-109004
アンテナ	なし	内蔵（パターンアンテナ）
Bluetooth無線技術規格	Bluetooth Core Specification Version 4.1 (single mode low energy radio) 準拠	
送信出力レベル	+4 dBm max. (APIで切替可能)	
受信感度	-88 dBm typical	
外部インターフェース	UART、SPI、I ² C、GPIO	
水晶振動子	内蔵	
電源電圧	1.9V~3.6V (LDOモード対応)	
消費電流	Tx モード	10.5mA typical (0dBm時)
	Rx モード	13mA typical
動作温度	-25°C~+75°C	
外形寸法	10.5×9.2×1.6 mm	15.7×9.8×2.0 mm
Bluetooth認証	取得済み(*)	
工事設計認証番号	007-AB0237	
取付方法	表面実装 (SMD)	

*モジュールでのBluetooth SIG認証を取得済みです。QDIDはお問い合わせください。

(注) 当社モジュールのQDIDを使用してお客様製品のBluetooth SIG登録が必要です(有償)。

*工事設計認証も取得済みです。アンテナ内蔵タイプ (MBH7BLZ02-109004) はFCC、IC、CEも取得済みです。詳細はお問い合わせください。

■評価ツール (別売)

形格	詳細	最小出荷単位
MBH-FUJI-E	評価用ボード	1個
MBH7BLZ02-DAU-EB3	ドーターボード (MBH7BLZ02-109004 ×1 搭載)	1個

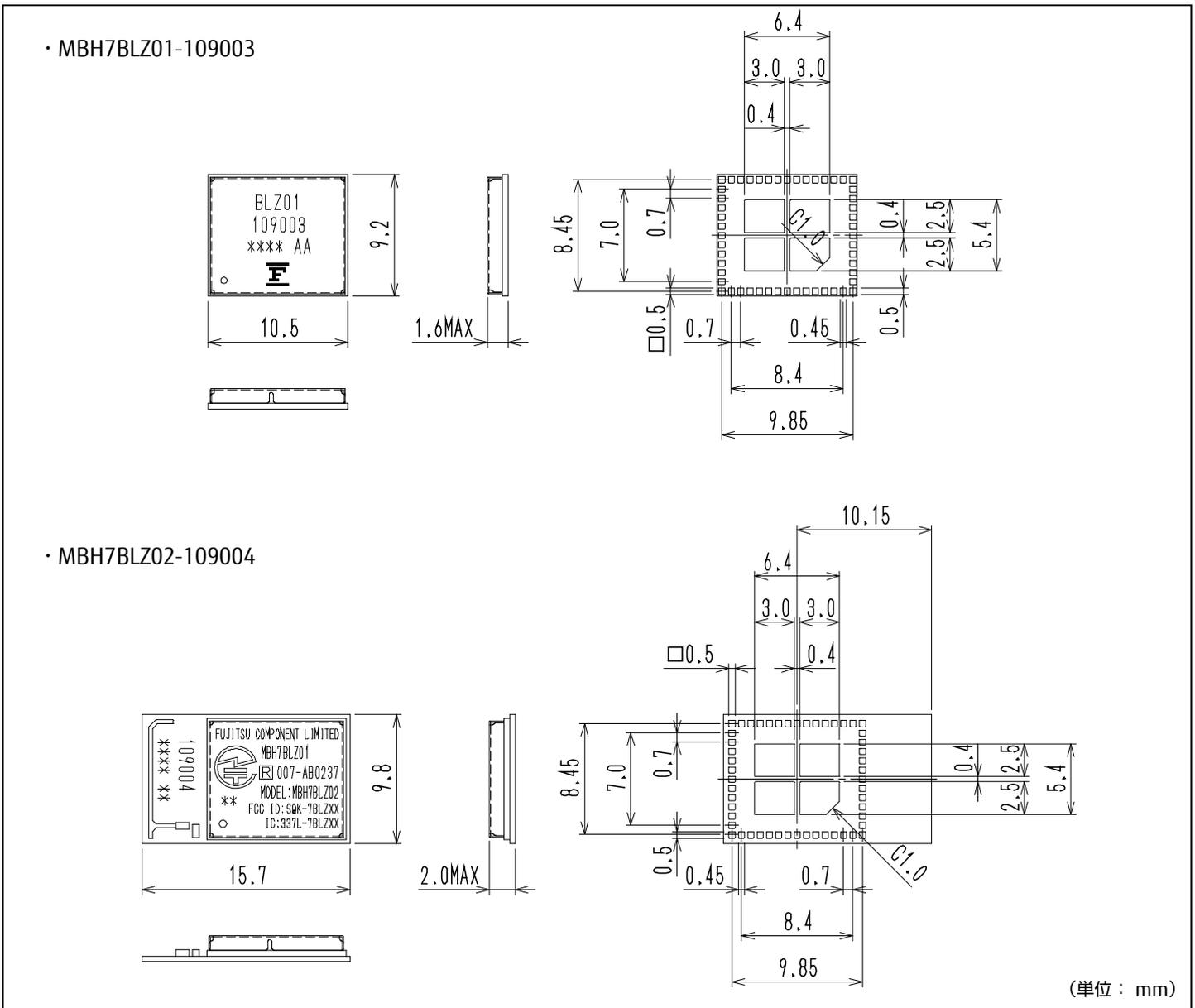
・評価には上記評価ツールの他にソフトウェア開発環境が必要です。詳細は当社営業までお問い合わせください。

■上位プロトコル、アプリケーション開発用ツールの入手について

以下のツール (ソフトウェア) をNordic Semiconductor ASAのWebサイト (URL: <http://www.nordicsemi.com>) からダウンロードできます。

・ Software Development Kit (“SDK”)

■外形寸法図



■最小出荷単位

形 格	最小出荷単位
MBH7BLZ01-109003	500個
MBH7BLZ02-109004	

⚠️ ご注意

- ・ご使用の場合は、仕様書または当社ホームページ掲載の「安全に関するご注意」「一般のご注意」をお読みのうえ正しくお使いください。
- ・表示された正しい電源電圧でお使いください。
- ・水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因になることがあります。
- ・本製品は、核反応制御や生命維持のための医療機器など極めて高度な安全性や信頼性を要求される用途向けではなく、一般用途向けに設計されています。

安全に関するご注意 <http://www.fujitsu.com/jp/fcl/products/wireless-modules/safety-notice.html>
 一般のご注意 <http://www.fujitsu.com/jp/fcl/products/wireless-modules/general-notice.html>

・ Bluetooth® ワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG Inc. が所有する登録商標であり、当社はこれらの商標を使用する許可を受けています。



お問い合わせ先

富士通コンポーネント株式会社

第二マーケティング部

東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

TEL: 03-3450-1645